



2023年12月15日

各位

会社名 株式会社 オキサイド
代表者名 代表取締役社長 (CEO) 古川 保典
(コード番号: 6521 東証グロース)
問合せ先 取締役副社長 (CFO) 山本 正幸
管理本部長
(TEL. 0551-26-0022)

第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

当社は、2023年12月15日付の取締役会において、ケーエルエー・テンコール株式会社（以下「ケーエルエー」又は「割当予定先」といいます。）に対して第三者割当の方式により新株式（以下「本新株式」といいます。）を発行すること（以下「本第三者割当」といいます。）を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 募集の概要

(1)	払込期日	2024年1月5日
(2)	発行新株式数	950,000株
(3)	発行価額	当社普通株式1株当たり2,959円
(4)	払込金額の総額	2,811,050,000円
(5)	調達資金の額	2,793,862,485円（注）
(6)	資本組入額の総額	上記「(4)払込金額の総額」欄記載の金額を2で除した金額（1円未満端数切上げ）とします。
(7)	募集又は割当方法 （割当予定先）	第三者割当の方法により、全ての新株式を割当予定先（ケーエルエー・テンコール株式会社）に割り当てます。
(8)	その他	上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 当社は、本日付で、上記割当予定先との間で、本新株式に係る投資契約（以下「本投資契約」といいます。）を締結いたしました。本投資契約の詳細につきましては、下記「6. 割当予定先の選定理由等 (5)本投資契約について」に記載しております。

（注）調達資金の額は、本新株式に係る払込金額の総額から、本新株式に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。

2. 募集の目的及び理由

当社は、単結晶（注1）、光部品、レーザ光源、光計測装置などの光学関連製品を、主に光を使った計測分野の装置メーカーや光学製品メーカー向けに開発・製造・販売しております。2000年の創業以来、単結晶・レーザのグローバルニッチトップ（注2）カンパニーを目指し、「研究成果を社会に還元し、キーマテリアル（注3）を世界に向けて発信する」、「顧客へマテリアルソリューション

ション（注4）を提供し、社会の発展に貢献する」、「単結晶を核とした製品を開発し、未来の市場機会を創造し続ける」という経営理念の下、光学分野のバリューチェーン（注5）の川上に位置する単結晶の開発・製造から事業を開始し、単結晶開発技術を生かしつつ、光学分野での川下の製品群（光部品、レーザ光源、光計測装置）へと展開してまいりました。

2021年4月に東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場した後は、成長を更に加速させるため、ディープテック（注6）分野のスタートアップへの投資や、M&Aも積極的に検討してまいりました。2023年3月にはイスラエルのRaicol Crystals社（注7）を25.3百万米ドルで買収（日本円で3,360百万円。1米ドル=132.82円 ※ 2022年12月23日時点参考レートとして算定しております。）いたしました。

当社は、売上高成長率20%を経営目標の一つに掲げて2021年2月期売上高3,579百万円（前年度対比116.8%）、2022年2月期売上高4,756百万円（前年度対比132.9%）、2023年2月期売上高5,752百万円（前年度対比120.9%）と成長してまいりました。

売上高成長を遂げる中でも、2021年2月期当期純利益310百万円、2022年2月期当期純利益495百万円、2023年2月期当期純利益557百万円と、着実に利益を計上しております。加えて、投資面では、2023年2月期において、研究開発費675百万円、設備投資費1,355百万円と事業成長の為の積極的な投資を継続しております。また、増収に伴う運転資本需要も売掛債権や棚卸資産の増加を中心に拡大傾向にあります。

2024年2月期の業績見通しにつきましては、2023年4月14日に開示しましたとおり、単体売上高予想は7,294百万円（前年度対比126.8%）、連結売上高予想は8,773百万円です。今期連結売上高の進捗ですが、2023年10月13日付の2024年2月期第2四半期決算でご説明しましたとおり、上半期売上高実績（2023年3月～8月）は半導体事業1,790百万円、ヘルスケア事業842百万円、新領域事業690百万円、全社合計で3,323百万円となります。

これら成長への積極的な投資、運転資本増加の充足、今期業績の不透明感へ対処するため、当社では、取引金融機関と緊密な関係を構築し、戦略的に有利子負債による資金調達をしてまいりました。2023年8月末時点での有利子負債は11,776百万円で、自己資本比率は約27%です。2023年3月1日から2023年8月末までの現金及び現金同等物の増減は△145百万円で、2023年8月末時点での現金及び預金は1,292百万円です。同期間中の営業キャッシュ・フローは△1,528百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは5,725百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは7,091百万円です。

こういった旺盛な投資資金の需要に対して、当社では株主資本のみならず借入金を活用することで最適な資金調達を検討する必要があると認識しております。同時に、財務体質の強化を図ることの重要性も認識しており、そのバランスが肝要であると考えております。当社としては、現在の事業環境、足元で行ってきた投資に加えて、割当予定先の戦略的価値を勘案し、今回、有利子負債を圧縮することにより、財務体質の強化と今後のさらなる成長に向けた基盤整備を図るため、ケーエルエーを割当予定先として本第三者割当を行うものです。今後、当社の事業拡大につながる施策を実行することで、企業価値及び株主価値の向上を図ることができると判断しております。本第三者割当の実施により自己資本比率を向上させることで、将来に渡る当社の資金調達選択肢の拡充に繋がると考えております。現在の自己資本比率水準に鑑みると、追加での借入金には慎重な対応が求められますが、本第三者割当を実施し自己資本比率を改善することで、借入と資本双方を選択肢とした柔軟な資金調達が可能となります。これら資金調達手法を活用して、半導体事業を中心とする既存事業のサプライチェーンの強化、新領域事業で取り組んでいるSiCと酸化ガリウムといったパワー半導体事業の研究開発促進、量子分野での量産化加速に取り組んでまいります。

なお、本新株式の発行による調達資金の具体的な資金使途及び支出予定期間につきましては、下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2) 調達する資金の具体的な使途」に記載しております。

(注) 1. 単結晶

- 原子、分子が規則正しく配列している固体を結晶と総称します。その結晶の中でも、物質内のどの部分においても原子、分子配列の向きがまったく同一である物質を単結晶と呼びます。
- 結晶に、電気信号を加えたり、圧力をかけたり、光を当てることにより、各結晶の持つ特性が現れますが、単結晶の場合は、その特性（例えば、光を当てることにより光の波長を変換したり、電気信号を加えることにより光の強度を調整すること。）が強く現れます。この特性を活用して、産業分野で単結晶応用製品が実用化されております。

2. グローバルニッチトップ

- 「グローバルニッチトップ企業 100 選」は経済産業省が 2013 年度より継続している事業です。「グローバルニッチトップ企業」の定義は、「昨今の産業構造の変化や、求められるニーズに迅速に対応するため、大企業や主要業界団体だけでなく、ニッチ分野（比較的小規模な市場や潜在的ニーズはあるが、まだ事業の対象として考えられていないような分野）において高い世界シェア（占有率）を有し、優れた経営を行っている中堅・中小企業」です。経済産業省として、認定と顕彰を通じて、対象企業の知名度向上や海外展開を支援するとともに、新たにグローバルニッチトップを目指す企業が経営上の羅針盤として活用することが目的となっております。

3. キーマテリアル

- 世の中の役に立つ材料を意味します。

4. マテリアルソリューション

- 材料と光に関する問題解決を意味します。

5. バリューチェーン

- 単結晶、ウエハ、チップ、光部品、レーザ光源、計測装置の光学分野における川上から川下に至る一連の製品供給プロセスを意味します。

6. ディープテック

- ディープテックとは、特定の自然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発見に基づく技術であり、その事業化・社会実装を実現できれば、国や世界全体で解決すべき経済社会課題の解決など社会にインパクトを与えられるような潜在力のある技術を意味します。

7. Raicol Crystals 社

- Raicol Crystals 社は、1995 年に創業したイスラエルの結晶メーカーであり、「宇宙・防衛」、「美容」、「エネルギー」、「量子」といった幅広い分野で使用される非線形光学結晶と電気光学デバイスの研究、開発、製造、販売を行っております。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

払込金額の総額	2,811,050,000 円
発行諸費用の概算額	17,187,515 円
差引手取概算額	2,793,862,485 円

(注) 1. 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

- 2. 発行諸費用の概算額は、弁護士費用及びその他事務費用（有価証券届出書作成費用及び登記費用等）の合計であります。

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記差引手取概算額 2,793 百万円については、下記表記載の資金使途に充当する予定であります。

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
有利子負債の返済	2,793	2024 年 1 月
合計	2,793	—

(注) 上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金で保管する予定です。

上記表中の資金使途に関する詳細は、以下のとおりです。

当社は、成長への積極的な投資資金と運転資本の増加を充足するためにこれまで金融機関からの借入を行っており、2023年8月末の時点の当社の有利子負債は11,776百万円（短期借入金2,400百万円、長期借入金9,211百万円、社債165百万円）となっております。

当社は、本新株式の発行による調達額2,793百万円全額を、2024年1月末までに、有利子負債の返済に充当する予定です。有利子負債返済の内訳は、短期借入金の返済485百万円、2025年3月末返済期限の長期借入金の返済2,308百万円、を予定しております。2023年8月末時点の当社の借入金の状況と、本第三者割当により調達した資金を有利子負債の返済に充当した場合の借入金の状況（2024年1月末時点）につきましては、以下のとおりです。なお、当社は、上記有利子負債の返済を行うことを本日付で決定し、別途プレスリリースにて開示いたしました。

2023年8月31日時点 借入金の状況

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
短期借入金	2,400,000	-	-	-	-	-	2,400,000
長期借入金	894,256	3,294,610	967,085	821,065	693,834	2,540,441	9,211,291
合計	3,294,256	3,294,610	967,085	821,065	693,834	2,540,441	11,611,291

注：こちらの借入金の状況の一覧には、当社社債165,000千円を含んでおりません。

2024年1月末時点 本第三者割当による調達額での返済後の借入金の状況

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
短期借入金	1,914,517	-	-	-	-	-	1,914,517
長期借入金	894,256	986,231	967,085	821,065	693,834	2,540,441	6,902,912
合計	2,808,773	986,231	967,085	821,065	693,834	2,540,441	8,817,429

注：こちらの借入金の状況の一覧には、当社社債165,000千円を含んでおりません。

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
返済額	485,483	2,308,379	0	0	0	0	2,793,862

注：こちらの返済額には、下記「10. 最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 (4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況」に記載した借入金の返済資金613百万円は含んでおりません。

4. 資金使途の合理性に関する考え方

当社は、本第三者割当により調達した資金を、上記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期(2)調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当し、有利子負債を圧縮することにより、財務体質の強化と今後のさらなる成長に向けた基盤整備を目指してまいります。

今後、当社の事業拡大につながる施策を実行することで、当社の成長戦略の実現や、財務内容が改善することによる企業価値及び当社の中長期的な株主価値の向上、並びに既存株主の皆様の利益拡大が図られるものと考えており、本第三者割当の資金使途については合理性があるものと考えております。

5. 発行条件等の合理性

(1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

本新株式の払込金額については、本新株式の発行に係る取締役会決議の前営業日（2023年12月14日）までの直前1か月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,115円（小数点以下を四捨五入。以下、平均株価の計算について同様に計算しております。）の95%に相当する金額である2,959円（小数点以下を切捨て）といたしました。かかる払込金額は、日本証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも配慮して決定されたものであり、特に有利な払込金額に該当しないものと判断しております。

なお、当該払込金額2,959円につきましては、本新株式の発行に係る取締役会決議日の直前取引日（2023年12月14日）の普通取引の終値2,938円に対して0.71%のプレミアム（小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプレミアム及びディスカウント率の数値の計算について同様に計算しております。）、同直前1か月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,115円に対して5.01%のディスカウント、同直前3か月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値2,896円に対して2.18%のプレミアム、同直前6か月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,212円に対して7.88%のディスカウントとなります。

払込金額の算定にあたっては、可能な限り恣意性を排除した客観的な株価に基づくことが重要であると認識しております。また、株式市場全体が不安定な値動きをしている場合や、当社の株価が不安定な値動きをする場合には、何らかの特殊な要因が株価の形成に影響を与えているのか否かを評価する必要があると認識しております。

当社といたしましては、取締役会決議の直前取引日の株価、直近1か月平均株価、直近3か月平均株価、直近6か月平均株価のうち、直近1か月平均株価であれば、取締役会決議の直前取引日の株価との乖離が少ないことを前提に、恣意性や特殊要因による短期的な変動を排除することが期待できるとともに、客観的な市場取引により形成された株価であり、当社の企業価値を反映していると判断しており、その95%に相当する金額である2,959円（小数点以下を切捨て）という払込金額は、取締役会決議の直前取引日の株価からのプレミアム率が0.71%となる点に照らしても、日本証券業協会が定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」において定める価額の範囲内であると考えております。

上記のとおり、当該払込金額は、本新株式の発行に係る取締役会決議日の直前1か月間の当社普通株式の普通取引の終値の平均値3,115円の5.01%ディスカウントとなっておりますが、当社の置かれた事業環境及び業績動向や株価推移を勘案して、割当予定先と協議の上で決定されており、日本証券業協会の「第三者割当の取扱いに関する指針」（2010年4月1日付）にも準拠していることから、割当予定先にとって、特に有利なものではないと判断いたしました。

なお、当社監査役3名（うち社外監査役2名）全員から、本新株式の払込金額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にしており、直近の株価及び直近1か月平均株価が現時点における当社の客観的企業価値を適正に反映していると判断した上で当社取締役会決議の前営業日における普通取引の終値及び直近1か月平均株価を基準として割当予定先と交渉が行われていること並びに日本証券業協会の指針も勘案して決定されていることから、本新株式の払込金額が割当予定先に特に有利な金額には該当しないものとする取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を得ております。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株式の発行により交付される株式の数は950,000株であり、2023年11月30日現在の当社発行済株式総数10,055,525株に対し9.45%（2023年11月30日現在の当社議決権個数100,355個に対しては9.47%）の割合の希薄化が生じます。

しかしながら、「2.募集の目的及び理由」「6.割当予定先の選定理由等(2)割当予定先を選定した理由」に記載のとおり、本第三者割当により、当社の事業価値の向上が期待できること、及び本第三者割当により調達した資金を、前述の資金用途に充当し、今後当社の事業拡大につながる施策を実行することで、当社事業の中長期的な発展を志向していく予定であることから、将来的に増大することが期待される収益力との比較において、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。

以上の理由により、当社といたしましては、本新株式の発行は、企業価値、株主価値の向上に寄与するものと見込まれ、既存株主の利益にも資するものと判断しており、今回の発行数量及び株式の希薄化規模は合理的であると考えております。

6. 割当予定先の選定理由等

(1) 割当予定先の概要

(1)	名称	ケーエルエー・テンコール株式会社		
(2)	所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目7番1号 OCEAN GATE MINATOMIRAI		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 深見 武		
(4)	事業内容	半導体製造工程に供する精密機器の輸入及び販売、並びに関連する技術サービス提供		
(5)	資本金	480 百万円		
(6)	設立年月日	1984 年 12 月 21 日		
(7)	発行済株式数	11,805 株		
(8)	決算期	6 月		
(9)	従業員数	530 名 (2023 年 6 月 30 日現在)		
(10)	主要取引先	半導体製造業者		
(11)	主要取引銀行	Citibank N.A.		
(12)	大株主及び持株比率	KLA Corporation (米国 NASDAQ 市場に上場する米国企業であり、以下「KLA 社」といいます。) (注 1) (89.8%) 及び KLA-Tencor Corporation (Cayman) Limited, III (10.2%)		
(13)	当事会社間の関係			
	資本関係	割当予定先の関係会社である KLA-Tencor (Singapore) Pte. Ltd. 及び KT Venture Group II, LLC が当社株式をそれぞれ 4.10% 及び 2.51% 保有しております。		
	人的関係	該当事項はありません。		
	取引関係	当社は、KLA グループ (注 2) との間で、深紫外レーザ (注 3) 向け非線形光学単結晶及び深紫外レーザに関する取引を行っております。		
	関連当事者への該当状況	割当予定先は当社の関連当事者には該当しません。また、割当予定先の関係者及び関係会社は当社の関連当事者には該当しません。		
(14)	最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
	決算期	2021 年 6 月期	2022 年 6 月期	2023 年 6 月期
	純資産	5,342	8,044	9,214
	総資産	31,075	51,897	51,344
	1 株当たり純資産 (円)	452,520	681,406	780,516
	売上高	29,021	36,886	46,013
	営業利益	3,160	4,016	3,553
	経常利益	3,048	3,912	3,601
	当期純利益	2,271	2,701	1,170
	1 株当たり 当期純利益 (円)	192,376	228,801	99,110
	1 株当たり配当金 (円)	-	-	-

(2023 年 12 月 15 日現在。特記しているものを除く。) (単位：百万円。特記しているものを除く。)

(注) 1. 割当予定先の親会社である KLA 社は米国 NASDAQ 市場に上場しております。当社は、割当予定先であるケーエルエー、同社役員又は主要株主について、反社会的勢力であるか否か、及び反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、日経リスク&コンプライアンスを用いた記事検索に加えてインターネット上の検索により、ケーエルエー、同社役員又は主要株主と反社会的勢力との係わり等を連想させる情報及びキーワードを検索いたしましたが、ケーエ

ルーエー、同社役員又は主要株主と反社会的勢力との係わりを疑わせるものは検出されませんでした。これにより、当社は、ケーエルエー、同社役員又は主要株主が反社会的勢力とは一切関係していないと判断し、これに係る確認書を東京証券取引所に提出しております。

2. 割当予定先であるケーエルエーの親会社である KLA 社を中心とする企業グループを、「KLA グループ」といいます。以下同じです。
3. 深紫外とは、紫外線の中で波長が短い 200~280nm 前後の波長領域を指します。この波長を発生する深紫外レーザーは、半導体製造プロセスでウエハの欠陥検査に利用されています。半導体の微細化の進展に伴い、深紫外レーザーに対して短波長化と高出力化が求められています。当社の深紫外レーザーは、自社で製造する高品質な光学単結晶を用いることより 266nm の深紫外光を 2W 以上の高い出力で発生することを特長としています。

(2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先であるケーエルエーの親会社である KLA 社は、米国カリフォルニア州に本社を置き、成長を続ける半導体市場の中でも重要視されている半導体製造過程で使用される検査測定装置分野における世界的なリーディング・カンパニーで、その装置は世界の主要半導体メーカーに採用されています。世界の半導体市場が拡大を続ける中、その主要な技術革新として半導体の微細化が進んでおります。微細化に対応するウエハの検査装置には、より短波長かつより高出力の深紫外レーザーと高品質な光学単結晶が求められており、その需要は年々拡大しています。当社製の高品質な光学単結晶は、KLA 社が開発し製造する半導体ウエハ検査装置（半導体製造工程で半導体ウエハ上の異物やパターン欠陥を検出する装置です。）に搭載されております。同製品の重要性は高く、KLA 社は、当社の光学単結晶の開発・製造・供給における比類ない能力、具体的には、深紫外光を発生しても劣化しにくい非常に品質の高い結晶を作ることができるという当社の強みを高く評価してきたといえます。当社と KLA 社は、2006 年に KLA 社が当社へ資本参画して以来、今日に至るまで長期間にわたる戦略的パートナーとして、資本、業務両面においてその関係を深めてまいりました。KLA 社は、世界の主要半導体メーカーに製品・サービスを供給していることから、半導体業界が将来必要とする製品の開発の指針となるべき事項を当社に伝えることができる重要な立場におり、この KLA 社から得られる半導体業界に関する独自の知見は、KLA 社との事業のみならず、当社の他の顧客との事業においても、半導体事業における事業拡大や最先端技術の開発の機会の創出を通じ、当社の成長に大きく寄与するものと、当社は考えております。

当社と KLA 社は恒常的に取引関係があり、幹部間でのミーティングも定期的に行われております。その中で本第三者割当の可能性について協議を始め、今日に至るまで協議を続けてまいりました。KLA 社からは、当社が堅固な財務体制に基づき独立した運営を継続することにより、半導体産業の維持発展にとって重要なユニークで差別化された製品を安定的に供給し続けることは、KLA 社の望みである、との考えが示されております。

なお、KLA グループは、これまで、グループ内の KLA-Tencor (Singapore) Pte. Ltd. 及び KT Venture Group II, LLC を通じて当社の株式を保有していましたが、本第三者割当にあたっては、KLA グループにおいて、グループ内の唯一の日本の会社であるケーエルエーを、今回の適切な割当予定先として選定したとのことです。

また、今般、当社は、KLA 社との間で、KLA グループに当社の株式保有比率を維持するための権利を付与する旨合意しましたが、本第三者割当に関する協議の中で、当社は KLA 社に対して、KLA グループが当社の支配権を取得する意向がない旨を確認しております。

また当社は、今回の資金調達に際し、以下の「(他の資金調達方法との比較)」に記載されている点を総合的に勘案した結果、第三者割当による資金調達が、現時点において最適な選択であると判断し、これを採用することを決定いたしました。

(他の資金調達方法との比較)

- ①公募増資や株主割当増資による株式の発行については、一般投資家や割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金を調達できるかどうか不透明であるため、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

- ②新株予約権の発行については、新株予約権の行使状況次第で、資金調達の総額及び時期が変動し、新株式の発行による第三者割当増資よりも資金調達の確実性が乏しいことから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。
- ③借入又は社債による資金調達については、調達額が全額負債となるため、財務健全性が低下し、今後の借入余地が縮小する可能性があることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

これらの検討の結果、第三者割当による本新株式の発行という資金調達手法は、当社株式に一定の希薄化が生じるものの、当社の財務基盤の強化、収益性の向上や企業価値の向上への寄与、株主価値の向上の観点から、現時点において最適な資金調達方法であると判断いたしました。

なお、当社は、調達する資金を上記「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期(2) 調達する資金の具体的な用途」に記載の用途に充当することで、当社の持続的成長及び企業価値向上を実現し、最終的には株主の皆様の利益の向上につながるものと考えております。

(3) 割当予定先の保有方針

本第三者割当に関する協議の中で、当社は割当予定先に対して、割当予定先の当社への投資は、本第三者割当の趣旨に鑑み、相互に協力関係を築きつつ、当社の企業価値向上に資することを目的として行われるものであることを確認しております。

また、当社は、割当予定先から、割当予定先が払込期日から 2 年以内に本第三者割当により発行される本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得する予定です。

(4) 割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容

割当予定先の銀行口座の 2023 年 12 月 8 日現在の残高証明書の写しを確認し、本新株式の払込金額の総額を上回る十分な預金残高を保有すること確認いたしました。このため、当社としましては、割当予定先が本第三者割当に係る払込みに要する十分な現預金を保有していることを確認しており、また、割当予定先からも、本第三者割当に係る資金拠出のほか、今後追加での資金拠出が仮に発生した場合についても払込みの対応に問題が無い旨を、割当予定先に対して、2023 年 12 月 8 日までに口頭で確認していることから、当社として、割当予定先の払込みに支障はないと判断しております。

(5) 本投資契約について

当社が 2023 年 12 月 15 日付で割当予定先との間で締結した本新株式に係る投資契約（以下「本投資契約」といいます。）においては、以下の内容が定められています。

- ① 当社は、本第三者割当により、割当予定先に対して当社普通株式 950,000 株を発行し、割当予定先はその全部を引き受けること。
- ② 今後、払込期日から起算して 3 年の間に、当社が新株式の発行又は自己株式の処分（以下「新株発行等」といいます。）を行う場合には、割当予定先は、当社に対し、新株発行等の実施後かつ潜在株式調整後の議決権比率が 15%を上回らない限度で、KLA グループの議決権比率を維持又は引き上げるための株式の割当てを割当予定先に対して行うことを請求することができる。ただし、当社グループの役職員に対する株式報酬に関連した新株発行等の場合を除く。
- ③ 当社は、当社の支配権の変更を伴う組織再編、第三者割当、資本提携等の一定の取引又は当社の半導体事業の全部若しくは重要な一部の移転を伴う資産の譲渡に関する交渉等の開始に先立って、割当予定先に対して通知を行い、割当予定先との間で交渉等を行うこと。当社と割当予定先の間で当該交渉等に係る取引が成立せず、当社と第三者との間で取引に係る合意が成立した場合には、割当予定先は、当該第三者と同等又は当社にとって少なくとも不利に

ならない条件で当該取引の相手方となることを当社に対して請求することができ、当社はこれを支持すること。

- ④ 当社は、KLA グループが当社普通株式を保有する限りは、当社の普通株式の発行又は処分の実施に際し、KLA グループが保有する当社株式の一部に係る売出しに一定の協力をを行うこと。ただし、当社グループの役職員に対する株式報酬に関連した普通株式の発行又は処分の場合を除く。
- ⑤ 当社は、KLA グループが当社の普通株式に係る発行済株式総数（自己株式を除く。）の 10% 以上の普通株式を保有する限りは、割当予定先に対し、以下を約束すること。
- (ア) 当社は、EBITDA に対する純負債の比率を一定の水準以下に維持するよう最大限の努力を行う。
- (イ) 当社は、割当予定先に対し、財務諸表、取締役会資料等を事後的に提供する。ただし、当該提供により、営業秘密を開示することとなる場合、又は利益相反若しくは法令違反等になる場合を除く。
- (ウ) 当社は、第三者に対し、その保有する重要な知的財産権の付与又は売却を行う場合には、当社の過半数に相当する株式の保有者の同意又は割当予定先の事前の書面による同意を得る。

7. 募集後の大株主及び持株比率

募集前（2023年8月31日現在）（注）		募集後	
古川 保典	7.69%	ケーエルエー・テンコール株式会社	8.68%
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社	6.70%	古川 保典	7.02%
NTT ファイナンス株式会社	5.00%	エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社	6.12%
KLA-Tencor (Singapore) Pte. Ltd.	4.10%	NTT ファイナンス株式会社	4.57%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.84%	KLA-Tencor (Singapore) Pte. Ltd.	3.75%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.65%	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.51%
KT Venture Group II, LLC	2.51%	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3.33%
株式会社ニコン	2.50%	KT Venture Group II, LLC	2.29%
レーザーテック株式会社	2.50%	株式会社ニコン	2.28%
株式会社山梨中央銀行	2.00%	レーザーテック株式会社	1.83%
株式会社内藤ハウス	2.00%	株式会社山梨中央銀行	1.83%
株式会社島津製作所	2.00%	株式会社内藤ハウス	1.83%
山梨中銀経営コンサルティング株式会社	2.00%	株式会社島津製作所	1.83%
—	—	山梨中銀経営コンサルティング株式会社	1.83%

(注) 1. 大株主及び持株比率は2023年8月31日現在の株主名簿上の株式数（自己株式393株を除きます。）に基づき記載しております。

2. 上記の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

8. 今後の見通し

当社は本第三者割当が、当社の企業価値及び株主価値の向上に資するものと考えております。

本第三者割当により 2024 年 2 月期の業績に与える影響につきましては、借入金返済による貸借対照表への影響が主であり、損益計算書への影響は借入金返済による支払い利息の減少ですが、返済予定時期が 2024 年 1 月であることを鑑みると今期業績への影響は軽微であると考えております。業績予想に変更が生じる場合にはすみやかに公表いたします。

9. 企業行動規範上の手続きに関する事項

本第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。

10. 最近 3 年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況

(1)最近 3 年間の業績

	2021 年 2 月期	2022 年 2 月期	2023 年 2 月期
売上高	3,579,619	4,756,708	5,752,663
営業利益	365,755	596,784	537,058
経常利益	322,887	598,991	687,871
当期純利益 (円)	310,458	495,740	557,395
1 株当たり当期純利益 (円)	41.13	52.53	56.50
1 株当たり配当額 (円)	—	—	—
1 株当たり純資産額 (円)	199.87	467.83	525.00

(単位：千円。特記しているものを除く。)

(注) 当社は、2020 年 11 月 9 日開催の取締役会決議に基づき、2020 年 11 月 27 日付で普通株式 1 株につき 500 株の株式分割、2022 年 12 月 14 日開催の取締役会決議に基づき、2023 年 3 月 1 日付で普通株式 1 株につき 2 株の株式分割を行っておりますが、2021 年 2 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して 1 株当たり純資産額、1 株当たり当期純利益を算定しております。

(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 (2023 年 11 月 30 日現在)

	株式数	発行済株式数に対する比率
発行済株式数	10,055,525 株	100%
現時点の行使価額 における潜在株式数	1,065,000 株	10.6%

(注) 上記潜在株式数は、ストックオプションによるものです。

(3)最近の株価の状況

① 最近 3 年間の状況

	2021 年 2 月期	2022 年 2 月期	2023 年 2 月期
始 値	—	6,540 円	2,337.5 円
高 値	—	10,300 円	5,000 円
安 値	—	3,990 円	2,082.5 円
終 値	—	4,600 円	4,260 円

(注) 1. 当社は、2021 年 4 月 5 日に東京証券取引所マザーズ市場 (現グロース市場) に上場しており、2022 年 2 月期の株価は上場日以降の株価を記載しております。

2. 当社は、2022年12月14日開催の取締役会決議に基づき、2023年3月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っており、2023年2月期の株価については、2023年2月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して記載しております。

② 最近6か月間の状況

	2023年 7月	8月	9月	10月	11月	12月
始 値	3,980 円	3,555 円	3,405 円	3,150 円	2,376 円	3,435 円
高 値	3,990 円	3,585 円	3,465 円	3,250 円	3,800 円	3,525 円
安 値	3,315 円	3,080 円	2,995 円	2,255 円	2,227 円	2,930 円
終 値	3,510 円	3,450 円	3,125 円	2,326 円	3,380 円	2,938 円

(注) 2023年12月の株価については、2023年12月14日現在で表示しております。

③ 発行決議日前営業日における株価

	2023年12月14日
始 値	3,055 円
高 値	3,085 円
安 値	2,930 円
終 値	2,938 円

(4) 最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況

① 公募増資（新規上場時）

払込期日	2021年4月4日
調達資金の額	1,918,000 千円（差引手取概算額）
発行価額	2,576 円
募集時における発行済株式数	3,781,500 株
当該募集による発行済株式数	750,000 株
募集後における発行済株式総数	4,531,500 株
発行時における当初の資金使途	<p>① 半導体事業における顧客が製造販売する半導体ウエハの検査装置に搭載するレーザの定期的なメンテナンス需要に対応するための第4工場に係る設備投資資金（建屋建設に882百万円、レーザ製造装置の購入に333百万円、システム投資に8百万円、小計1,223百万円）</p> <p>② ヘルスケア事業における増産に対応するための第3工場に係る単結晶製造装置の増設資金（単結晶製造装置の購入に100百万円（製造装置5台分に相当）、イリジウム坩堝の購入に400百万円（製造装置1台当たりイリジウム坩堝1個が必要となるため、イリジウム坩堝5個分に相当）、小計500百万円）</p> <p>③ 借入金の返済資金（上記①及び②の充当後の残額について） （下記②記載のオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による資金調達を含めた資金使途となっております。）</p>
発行時における	① 半導体事業における顧客が製造販売する半導体ウエハの検査装置

支出予定時期	<p>に搭載するレーザの定期的なメンテナンス需要に対応するための第4工場に係る設備投資資金(2022年2月期に1,223百万円)</p> <p>② ヘルスケア事業における増産に対応するための第3工場に係る単結晶製造装置の増設資金(2023年2月期に500百万円)</p> <p>③ 借入金の返済資金(上記①及び②の充当後に613百万円)</p> <p>(下記②記載のオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による資金調達を含めた支出予定時期となっております。また、具体的な充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。)</p>
現時点における充当状況	<p>① 当初、2022年2月期に1,223百万円を充当する予定でしたが、工場建設用資材納期延伸により一部遅延しており、2023年10月末時点で1,181百万円を充当しております。残額の42百万円に関しては、2024年2月期中に第4工場に係る設備投資に充当する予定です。</p> <p>② ヘルスケア事業における増産に対応するための第3工場に係る単結晶製造装置の増設資金については、2022年2月期に500百万円を充当しております。</p> <p>③ 調達資金の総額から①及び②を除く残額613百万円は、上記①及び②の充当後に借入金の返済に充当する予定です。</p> <p>(下記②記載のオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による資金調達を含めた充当状況となっております。)</p>

② 第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

払込期日	2021年5月7日
調達資金の額	418,342千円
発行価額	2,576円
募集時における発行済株式数	4,531,500株
当該募集による発行株式数	162,400株
募集後における発行済株式総数	4,693,900株
割当先	野村証券株式会社
発行時における当初の資金用途	<p>① 半導体事業における顧客が製造販売する半導体ウエハの検査装置に搭載するレーザの定期的なメンテナンス需要に対応するための第4工場に係る設備投資資金(建屋建設に882百万円、レーザ製造装置の購入に333百万円、システム投資に8百万円、小計1,223百万円)</p> <p>② ヘルスケア事業における増産に対応するための第3工場に係る単結晶製造装置の増設資金(単結晶製造装置の購入に100百万円(製造装置5台分に相当)、イリジウム坩堝の購入に400百万円(製造装置1台当たりイリジウム坩堝1個が必要となるため、イリジウム坩堝5個分に相当)、小計500百万円)</p> <p>③ 借入金の返済資金(上記①及び②の充当後の残額について)</p> <p>(上記①記載の公募増資(新規上場時)による資金調達を含めた資金用途となっております。)</p>
発行時における支出予定時期	① 半導体事業における顧客が製造販売する半導体ウエハの検査装置に搭載するレーザの定期的なメンテナンス需要に対応するための第4工場に係る設備投資資金(2022年2月期に1,223百

	<p>万円)。</p> <p>② ヘルスケア事業における増産に対応するための第3工場に係る単結晶製造装置の増設資金(2023年2月期に500百万円)</p> <p>③ 借入金の返済資金(上記①及び②の充当後に613百万円) (上記①記載の公募増資(新規上場時)による資金調達を含めた支出予定時期となっております。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。)</p>
<p>現時点における充当状況</p>	<p>① 当初、2022年2月期に1,223百万円を充当する予定でしたが、工場建設用資材納期延伸により一部遅延しており、2023年10月末時点で1,181百万円を充当しております。残額の42百万円に関しては、2024年2月期中に第4工場に係る設備投資に充当する予定です。</p> <p>② ヘルスケア事業における増産に対応するための第3工場に係る単結晶製造装置の増設資金については、2022年2月期に500百万円を充当しております。</p> <p>③ 調達資金の総額から①及び②を除く残額613百万円は、上記①及び②の充当後に借入金の返済に充当する予定です。(上記①記載の公募増資(新規上場時)による資金調達を含めた充当状況となっております。)</p>

(別紙)

株式会社オキサイド 新株式発行要項

1. 募集株式の種類及び数
普通株式 950,000 株
2. 募集株式の払込金額
1 株当たり 2,959 円
3. 払込金額の総額
2,811,050,000 円
4. 申込期日
2024 年 1 月 5 日
5. 払込期日
2024 年 1 月 5 日
6. 増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額：1,405,525,000 円
増加する資本準備金の額：1,405,525,000 円
7. 募集及び割当の方法
第三者割当の方法により、すべての新株式をケーエルエー・テンコール株式会社に割り当てる。
8. 払込取扱場所
株式会社横浜銀行 川崎支店
9. その他
 - (1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
 - (2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
 - (3) その他新株式発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長(CEO)に一任する。

以 上